

INVESTOR RELATIONS

2019. 3Q YMT IR BOOK

Your Most trustworthy



유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있으며, 이러한 “예측정보 ” 는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

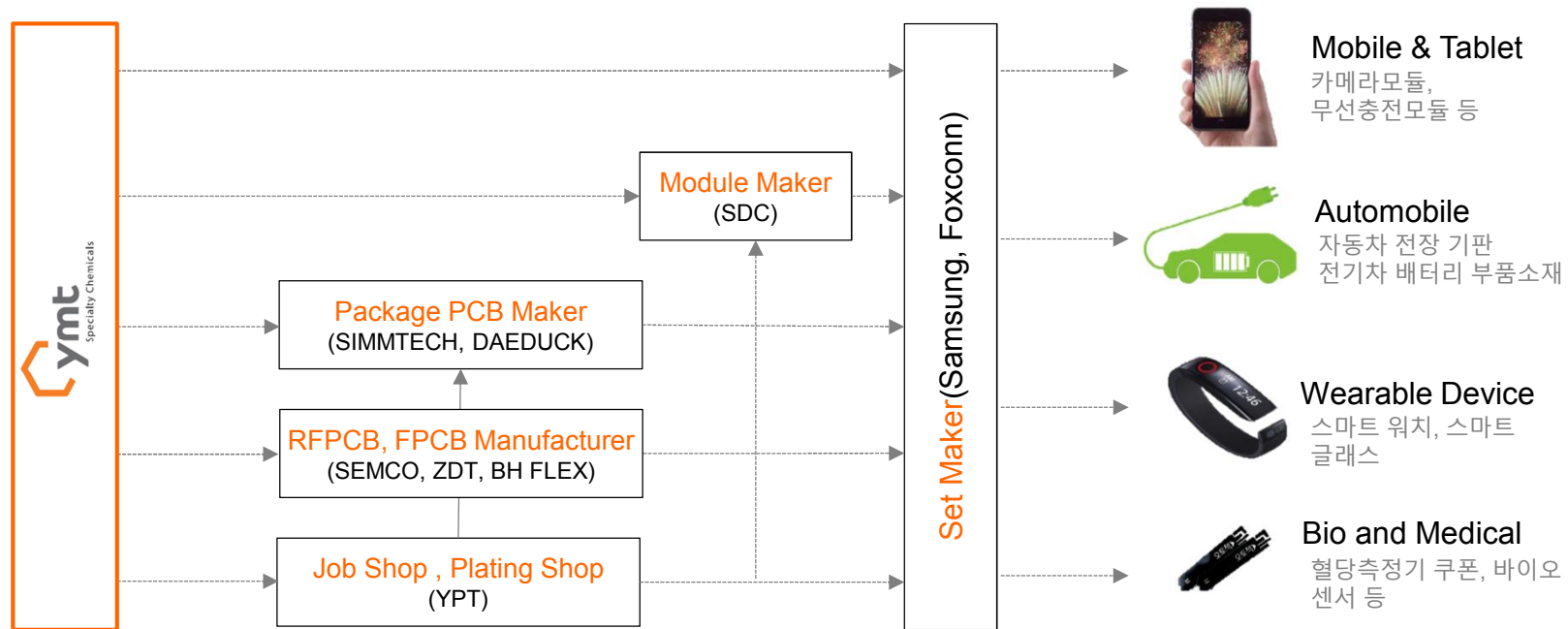
- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보 ” 에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



Company Introduction

와이엠티는 PCB 제조공정에 사용되는 고부가가치 표면처리 화학소재를 직접 연구/생산/공급 하는 회사로 High-end 표면처리소재분야에 강점을 둔 Global 화학소재 회사입니다.



한국, 중국, 베트남에 위치한 FPCB, RFPCB 제조사들에게 당사의 화학소재를 공급 중에 있으며, 기존 FPCB 표면처리분야의 기술력을 바탕으로 PKG PCB시장, 전자소재 분야로 시장확대 중에 있습니다.

Global
YMT



YMT Co.,Ltd. (KOREA, Head Quarter)

- Incheon, Korea.
- Chemical Division, Materials Division.
- 3 Factories in Nam-Dong Industry area.
- 2 R&D Center.
- Main Manufacturing location

YMT Co.,Ltd. Taiwan Branch

- Taoyuan, Taiwan
- Sales and Promotion for Chinese and Taiwanese customer

YMT China (Shenzhen) Co.,Ltd.

- Shenzhen, China
- 2 Branches : Pinhong, Kunshan Branch
- Constructing Factory in Zhuhai (Pinhong, Branch)

YMT Vina Co.,Ltd.

- Bac-ninh, Vietnam
- Chemical Division, Plating outsourcing
- Vin-Phuc Branch : Manufacturing Location.

YPT Co.,Ltd.

- Ansan, Korea
- Plating Outsourcing : ENIG, ENEPIG, Via-Fill
- R&D Center

Beyond Solution

- Ansan, Korea
- Plating Machine R&D
- Equipment management service

2019 YMT INVESTOR RELATIONS

Customer List

PCB Maker <i>Direct Customer</i>	    
	    
	    
Set Maker	     
Semi- conductor Maker	   
Display Maker	  

Your most trustworthy

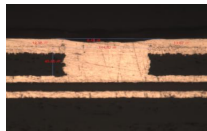
Products Introduction

Chemical Business



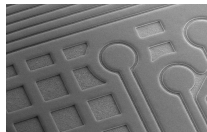
최종표면처리 화학소재

- 기판 표면의 보호와 부식방지를 위해 금, 팔라듐 등의 귀금속을 이용하여 PCB 표면을 도금
 - ✓ FPCB, RFPCB용 금도금 세계 점유율 1위
 - ✓ Apple, Samsung mobile 채택



동도금 화학소재

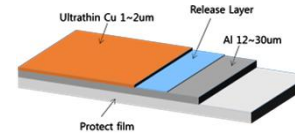
- Multi layer 기판의 층간 전기적 연결을 형성하는 공정
 - ✓ 무전해화학동 : 부도체 물질에 화학적 전도성 부여
 - ✓ 전기동 : 동의 석출로 동 두께를 형성



Process Chemical

- 기판의 회로를 형성하기 위한 식각, 현상 프로세스 및 기타약품
 - ✓ PCB용 식각, 현상, 감광액 등
 - ✓ MSAP용 회로약품
 - ✓ Flux Cleaner

Others



Electronic Materials

- **Materials**
 - ✓ Ultra-thin copper Foil
 - ✓ EMI Shiled
- **Roll to Roll**
 - ✓ RTR 동도금 외주



기판 가공 [YPT]

- **금도금외주**
 - ✓ FPCB, RFPCB 외주
 - ✓ 카메라모듈기판 외주
- **Via-fill 동도금 외주**



장비매출 [Beyond Solution]

- **금도금, 동도금 장비 판매, 이전 설치 및 유지보수 Service**
 - ✓ YMT 약품과 Binding
 - ✓ Via - Fill 장비개조, 고객사 베트남 공장이전 등

Foldable & 5G

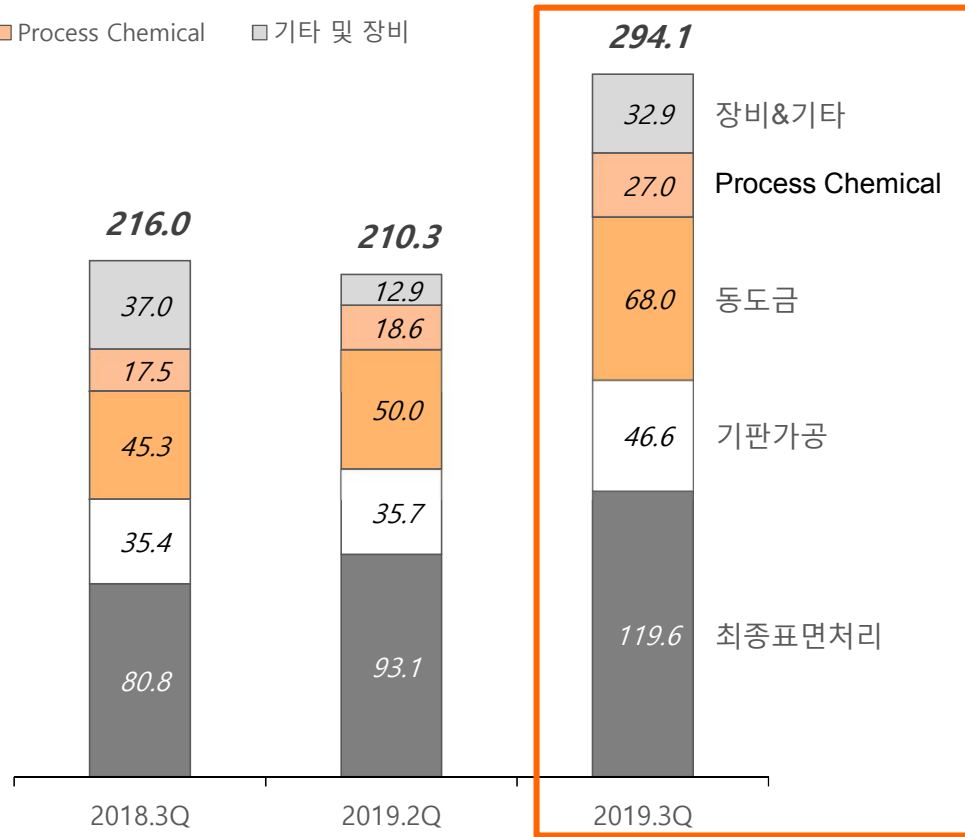
1) Foldable 스마트폰의 출시, 2) 5G 시장의 개화



대당 PCB 탑재 수 증가	PCB 고도화	소재의 변화
<ul style="list-style-type: none"> • 디스플레이 PCB 탑재 수량·면적 증가 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 갤럭시 Fold 에 2개의 패널 PCB 장착 ✓ 고화질·고면적 디스플레이 PCB 채택 • 배터리용 PCB 증가 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 디스플레이 면적 및 대수 증가 등에 따른 배터리팩 증가 • 카메라모듈 수 증가 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 총 6개의 카메라 모듈 탑재 • LDS에서 FPCB로 안테나 사양 변화 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 5G 고주파 대응을 위한 안테나 대수 증가에 의해 얇은 FPCB로 전환 	<ul style="list-style-type: none"> • SLP 시장 확대 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 배터리 등 모듈 확대에 따른 공간 부족 ✓ HDI 소형화 필수 • Fine pitch needs 증가 <ul style="list-style-type: none"> ✓ PCB 면적은 줄어드나, 모듈의 증가로 PCB 내 회로 면적 증가 ✓ 고객사의 고사양 약품 needs 증가 • 고다층 PCB 확대 <ul style="list-style-type: none"> ✓ PCB 면적 감소에 따른, 고다층 PCB의 고사양화 ✓ Via Fill 등 High-end 고다층 PCB 기술에 대한 시장 needs 확대 	<ul style="list-style-type: none"> • 극동박에 대한 니즈 증가 <ul style="list-style-type: none"> ✓ SLP 필수소재로 PCB 경박단소화 트렌드에 필수적인 소재 • EMI 차폐소재 변화 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 5G 고주파 대응을 위한 모바일 차폐소재 변화 • 신호전송률 손실 방지를 위한 소재 변화 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 5G 에서 가장 중요시되는 신호손실방지를 위한 다양한 소재와 공법의 변화가 요구됨 ✓ 저조도동박, 무에칭조도형성공법 등
<p>당사 Major 고객사 수혜 전망 PCB 전체 시장의 규모 증가</p>	<p>Chemical ASP 상승 예상 주요 고객사와 현재 초도 납품 중</p>	<p>Nanotus 개발중(무에칭공법) 주요 고객사와 극동박 test 중</p>

Sales Result

최종표면처리 기판가공 동도금 (단위:억원)
 Process Chemical 기타 및 장비



- **19년 3Q 294.1억원으로 최대 분기 매출 달성**
 - ✓ 18년 동기 대비 78.1억원(36.1%) 상승
- **Chemical 제품군의 지속적인 성장**
 - ✓ 전년 동기 대비
 - 최종표면처리 38.8억원(48%) 상승
 - 동도금 22.7억원(50%) 상승
 - ✓ 고객사 본격 양산에 따른 물량 확대
 - 상반기 점유율 상승에 따른 증폭 효과
- **기판가공(와이피티) Via-Fill 본격 양산**
 - ✓ 카메라모듈용 PCB 등 ENEPIG 외주물량의 회복
 - ✓ Via-Fill 본격 양산 시작(9월~)

2019 4Q 및 2020 Business 전망

Market Forecast

- 국내 S社 신규모델의 양산 예정 (12月 中)
- 고객사 양산 지속에 따른 Chemical 및 기판가공 매출의 YoY 성장세 유지 전망

Chemical Business

최종표면처리

- 북미 A社의 OLED Display 전모델 적용에 따른 관련 소재 매출 확대 예상
- 듀얼, 트리플 카메라 장착 모델 증가에 따른 중국 시장 매출 성장 (카메라모듈용 ENEPIG 소재)
- 駐베트남 고객사의 가동률 상승에 따른 매출 증가

동도금

- 고객사 내 점유율 확대와 시장 물량 확대(북미 A社)로 성장 계속 전망
- 고부가가치 전기동(Via-Fill) 매출 확대

Process Chemical

- SLP 및 Package (반도체 실장) 기판 관련 매출 확대
- Nanotus, 저조도에칭 프로세스등 5G 관련 신규 프로세스 시장 진입

Others

기판외주가공

- 베트남 기판가공 연내 본격 양산 시작
- 국내 Via Fill(전기동도금) 외주 양산 중, 물량 지속 확대

소재사업부문

- S社 向 EMI 차폐소재 공급 中
- 고객사 수요 증가 및 국산화 Needs 증가로 설비증설 검토 中
- F-PCB 기초소재(FCCL) 용 동박 수요 증가

기계장치, 상품 등

- 고객사 해외이전으로 장비 관련 수요 상승, 고사양 PCB 도금 장비 매출 확대
- 장비 Biz 중국시장 런칭

Income Statement

(단위:억원)

	제 21기 3분기	매출비중	제 20기 3분기	매출비중
I. 매출액	681.4	100	517.8	100
II. 매출원가	421.2	61.81	315.7	60.98
III. 매출총이익	260.2	38.19	202.1	39.02
판매비와 관리비	91.2	13.38	93.5	18.06
IV. 영업이익	169.0	24.81	108.6	20.96
기타수익	10.8	1.59	6.2	1.19
기타비용	7.5	1.11	8.5	1.63
금융수익	20.9	3.07	10.8	2.09
금융비용	9.1	1.34	12.0	2.31
지분법손익	0.1	0.01	0.1	0.01
V. 법인세차감전순이익	184.2	27.03	105.2	20.31
법인세비용	42.6	6.25	24.6	4.74
VI. 당기순이익	141.6	20.78	80.6	15.57

주요 수익성 지표

	21기 3분기	20기 3분기
영업이익률	24.81%	20.96%
순이익률	20.78%	15.57%
EBITDA (마진율)	223.9 (32.86%)	137.4 (20.17%)
ROE	15.84%	9.78%
총자산회전률	49.43%	56.52%

Balance Sheet

(단위:억원)

	제 21기 3분기	제 20기
자산		
현금성자산	300.2	276.1
매출채권	288.8	206.6
유형자산	622.3	560.5
기타자산	256.8	227.6
자산총계	1,486.1	1,270.8
부채		
매입채무	53.6	37.8
차입금	347.6	329.9
전환사채	69.2	68.9
기타부채	129.8	90.1
부채총계	600.2	526.7
자본		
자본금	37.0	37.0
자본잉여금	219.5	219.5
이익잉여금	511.9	403.4
기타자본	117.5	84.2
자본총계	885.9	744.1
부채와 자본계	1,486.1	1,270.8

Cash Flow

(단위:억원)

	제 21기 3분기	제 20기 3분기
기초현금	276.0	224.2
영업활동으로 인한 현금흐름	95.3	71.5
순이익	141.6	80.6
감가상각비	35.0	26.7
대손상각비	(7.1)	1.3
법인세비용	42.6	24.6
외화환산이익	(10.7)	(5.5)
자산부채의 변동	(92.4)	(40.6)
투자활동으로 인한 현금흐름	(86.4)	(128.1)
유형자산의 증가	(84.5)	(128.2)
재무활동으로 인한 현금흐름	6.3	60.3
차입금 증감	17.7	(9.9)
전환사채 발행	-	70.0
현금증감	15.2	3.7
환율변동효과	9.0	1.4
기말현금	300.2	229.3

END OF DOCUMENT

감사합니다.